

| | | Seite |
|---|---|-------|
| <i>U. Behringer und O. Fortagne</i> | Lithographie der Zukunft | 1 |
| <i>R. Pforr, K. Ronse und L. Mader</i> | OAI, PSM and OPC – A review of aerial image enhancing techniques for optical projection lithography | 19 |
| <i>H. Hartmann, E. Eisenmann und T. Waas</i> | Optische Proximity Korrekturmethode in der Maskentechnik zur Verbesserung der Abbildungseigenschaften | 45 |
| <i>S. Steuber, G. Groß, W. Ziegler, C. Kalus, L. Taini, K. Juffermanns und P. Prewett</i> | First Experience with Phase-Shift-Mask Technology | 51 |
| <i>P. Hahmann und W. Lelle</i> | WePrint 200, der Übergang vom variablen Formstrahl zur Minireticles-Projektion | 87 |
| <i>K. Reimer, B. Wenk, L. Buchmann, U. Schnakenberg und H. Elsner</i> | Minireticle für die Elektronenstrahlolithographie | 97 |
| <i>I. W. Rangelow, P. Hudek, F. Shi, I. Kostic, R. Kassing, H. Löschner, A. Chalupka, E. Hammel, G. Stengl, H. Vonach</i> | Stencil Masken für die Ionen-Projektions-Lithographie und für die maskierte Ionenstrahl-Lithographie | 113 |
| <i>M. Schmidt, W. Ehrfeld und H. Lehr</i> | Röntgentiefenlithographie – LIGA-Technik | 119 |
| <i>A. Siebert</i> | Finite-Elemente Berechnungen zur Maskentechnik | 133 |
| <i>H.-J. Brück, G. Falk, J. Helbing und L. Walden</i> | Anwendungen lichtoptischer Verfahren zur Strukturbreiten- und Overlay-Messung | 151 |
| | Referenten | 167 |